

サイドコンタクト SIDE CONTACT / OGSC



側面方向への導通が可能な自動実装グランド部材

Automated mounting applicable component for grounding with side-contact on PC board.

特長

Feature

- 基板端面付近で側面方向の筐体への導通が可能です。
- 垂直位置関係に配された基板-筐体間の導通が可能です。
- Side-contact is applicable on PC board edge against chassis.
- Grounding contact is applicable between mother PC board and vertically placed daughter board.

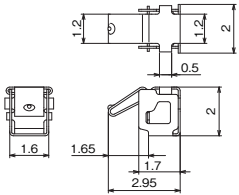
圧縮抵抗特性データ

Compression force vs Electric resistance

使用例

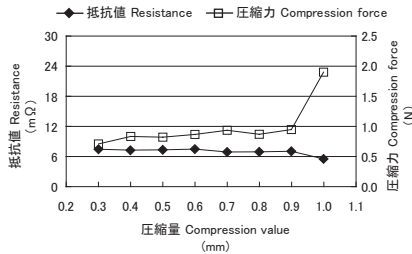
Application examples

OGSC-T-302020

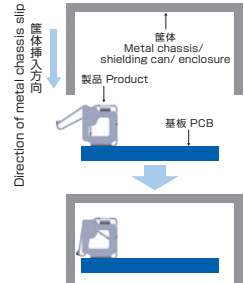


材料: コルソン合金(t=0.08mm)
Material: Corson alloy (t = 0.08mm)
表面処理: Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating

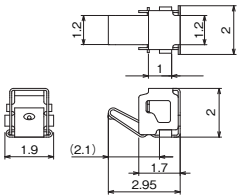
■ OGSC-T-302020



■ OGSC-T-302020

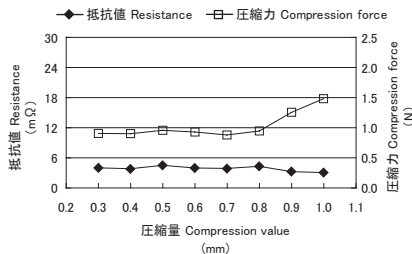


OGSC-B-302020

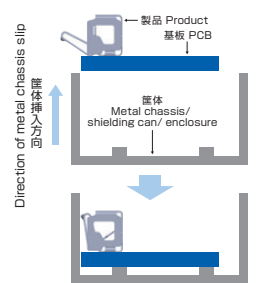


材料: コルソン合金(t=0.08mm)
Material: Corson alloy (t = 0.08mm)
表面処理: Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating

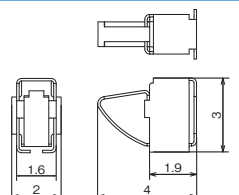
■ OGSC-B-302020



■ OGSC-B-302020

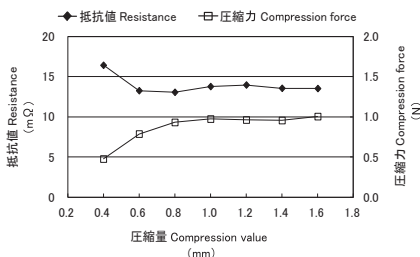


OGSC-402030

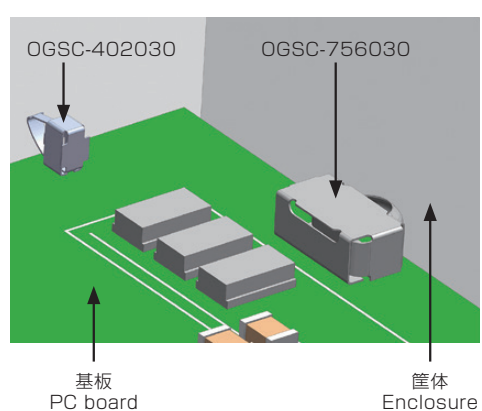


材料: ばね用りん青銅(t=0.1mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t = 0.1mm)
表面処理: Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating

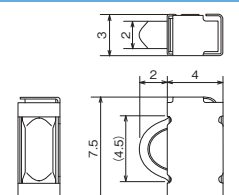
■ OGSC-402030



■ OGSC-402030 / OGSC-756030

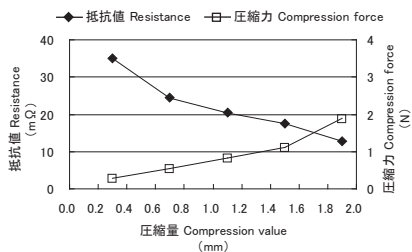


OGSC-756030



材料: ばね用りん青銅(t=0.12mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t = 0.1mm)
表面処理: Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating

■ OGSC-756030



単位/Unit:mm

※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。
※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.

※参考実測データ/保証値ではありません。

※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.